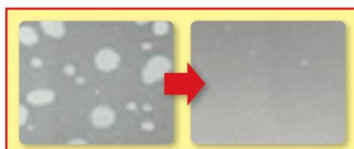


ギ酸還元・水素還元両対応!

タッチパネル式 卓上型 真空はんだリフロー装置

RSS-210-S

本装置は、基板やウエハー上の電極面や、銅ナノ粒子の表面にある、接合不良原因の酸化膜を、ギ酸の還元効果で簡単に除去します。



通常のリフローに加え、鉛フリー、ボイドレス、フラックスレスなどの各リフローが可能です。

- 卓上サイズながら最大到達温度400℃を実現しました。(オプション時:最大到達温度:500℃)
- 最大200×200mm基板に対応します。
- 下面からのIP(赤外)ヒーターによる加熱で、正確で高速な加熱が行え、最高180K/minの高速昇温が可能です。
- タッチパネル式モニターを標準装備し、タッチ操作による簡単なオペレーションが可能です。



寸法: 430(W)×295(D)×290(H)mm



光学ズームマイクロスコープにより、
チャンバー内の観察・記録が可能!

10×光学ズームマイクロスコープ AZ9シリーズ

- 90mmの作動距離(WD)と光学10倍ズーム、3μmの分解能を実現しました。
- RSS-210-S本体に付いたのぞき穴(石英ガラス製10mm厚)を透過しても、シャープかつクリアに見えます。
- リフロー本体のプログラム運転と同期して観察できます。
- 観察データはデジタルカメラによりPCに保存できます。

UNTEMP
Universal Temperature Processes
ユニテンプジャパン株式会社

★詳細説明やデモのご希望など、お気軽にお問合せください。
〒194-0014 東京都町田市原町田2-6-13ベルストーク1-2階
TEL:042-860-7890 FAX:050-3730-8404
<https://www.unitemp.jp/> E-mail:sales@unitemp.jp